

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-025



上海新阳半导体材料股份有限公司

2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 309256158 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李昊	张培培	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
传真	021-57850620	021-57850620	
电话	021-57850066	021-57850066	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司业务及产品

公司始终坚持自主研发，持续进行技术创新，经过二十多年发展，主要形成两大类业务，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务，并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。主要产品包括：

#### 1、晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品

晶圆制造及先进封装用电镀液和添加剂系列产品为公司面向芯片制造领域开发的第二代电子电镀产品。主要包括大马士革铜互连、TSV、Bumping 电镀液及配套添加剂。

## 2、晶圆制造用清洗液、蚀刻液系列产品

晶圆制造用蚀刻后清洗液、研磨后清洗液以及蚀刻液系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子清洗液系列产品。主要包括铜制程蚀刻后清洗液、铝制程蚀刻后清洗液、氮化硅/钛蚀刻液、化学机械研磨后清洗液等。

## 3、集成电路制造用高端光刻胶产品系列

集成电路制造用高端光刻胶系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子光刻系列产品。包括 I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 干法、浸没式光刻胶以及稀释剂、底部抗反射膜 (BARC) 等配套材料, 主要用于逻辑、模拟和存储芯片生产制造。

## 4、晶圆制造用化学机械研磨液

公司化学机械研磨液主要包括适用于浅槽隔离研磨液 (STI Slurry)、金属钨研磨液 (W Slurry)、金属铜研磨液 (Cu Slurry), 硅氧化层研磨液 (Oxide Slurry), 多晶硅层研磨液 (Poly Slurry) 等系列产品, 研磨液产品可覆盖 14nm 及以上技术节点。

## 5、半导体封装用电子化学材料

半导体封装用电子化学材料为用于半导体引线脚表面镀锡的化学材料及其配套电镀前处理、后处理化学材料, 是公司面向传统封装领域开发的第一代电子电镀与电子清洗产品, 包括无铅纯锡电镀液及添加剂、去毛刺溶液等。

## 6、配套设备产品

配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。

## 7、氟碳涂料产品系列

环保、功能性氟碳涂料包括: PVDF 氟碳粉末涂料、氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、超细耐候粉末涂料等。

## 8、其它产品与服务

其它产品与服务主要为围绕半导体产业和泛半导体产业开展的相关业务，主要在子公司进行。包括：晶圆湿法工艺技术开发与服务、晶圆划片刀、平板显示用光刻材料、集成电路制造用抛光液磨料的研发等。

## （二）主要经营模式

### 1、研发模式

公司围绕自身的核心技术，面向集成电路产业当前和未来需求，以自主研发、自主创新为主，开展集成电路制造用关键工艺材料的研发和产业化。始终坚持以技术主导为核心，持续研发创新，积极融入国家创新体系。通过自主评估并结合国家科技重大专项的需求设立研发项目，开展产品开发、应用技术开发和生产工艺开发。同时与客户保持密切合作，针对性研发满足客户需求的产品，为其开发创新性的解决方案。通过对产品性能的不断优化及应用和生产工艺的提升，持续满足客户的需求。

### 2、采购模式

公司根据 ISO 质量体系要求，制定了《采购控制程序》，《采购流程》《供应商管理流程》做到规范化，系统化的执行各项采购工作。

a. 一般材料需求部门根据计划或者实际情况提交采购申请，实行采买；

b. 原材料采购，由需求部门提出材料需求，由质量部，技术中心共同评估材料的指标性能，招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应；

c. 固定资产和工程类采购，由相关部门参与评审，招标后按合同约定开展。

### 3、生产模式

公司采用以销定产的方式确定生产量。计划部每月月初根据市场部统计的订单情况以及备货策略，编制当月的生产计划，生产部合理安排实施当月生产。每周生产部和计划部还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，以满足客户的产品需求的同时提高产品周转率。

### 4、销售模式

公司采用的是直销模式。公司在半导体材料领域深耕二十多年，积累了良好的客户资源，并和其中的一些客户形成了战略合作关系。公司市场部负责跟进、整理公司所属行业发展情况，制定公司市场战略规划，制定公司业务目标以及产品市场的开发和产品销售工作。公司市场人员直接与客户进行商务洽谈，达成初步交易意向，签订销售合同。市场部销售人员负责与客户进行订单确认、评审、发货计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司持续为客户提供优质产品和服务的同时，通过挖掘已有客户新需求和不断开发新客户保证公司营业收入的持续增长。

## 5、服务模式

公司在集成电路制造用关键工艺材料及设备领域深耕细作，在为客户提供优质产品的同时，更能为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案，快速响应客户需求，多方位整合公司资源，创新研发，为客户带来丰富和优质的服务方案，提升客户的产品竞争力。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,620,352,67 3.68	6,644,193,63 7.66	6,652,746,03 9.73	-15.52%	6,090,345,83 9.28	6,117,720,65 4.09
归属于上市公司股东的净资产	4,113,567,34 7.16	4,970,184,42 9.60	4,984,546,81 0.56	-17.47%	4,729,516,06 8.89	4,750,872,88 3.70
	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,195,686,06 4.34	1,016,358,53 6.49	1,016,367,38 6.05	17.64%	693,885,788. 88	693,885,788. 88
归属于上市公司股东的净利润	53,234,183.5 4	104,116,259. 89	93,668,329.4 0	-43.17%	274,335,577. 72	265,692,392. 53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,611,267. 84	95,166,311.1 8	84,718,380.6 9	31.74%	46,815,907.6 6	38,172,722.4 7
经营活动产生的现金流量净额	- 38,609,613.8 5	191,324,608. 93	175,828,684. 82	-121.96%	179,553,450. 96	169,026,536. 61
基本每股收益 (元/股)	0.1707	0.3384	0.3044	-43.92%	0.9439	0.9141
稀释每股收益 (元/股)	0.1707	0.3384	0.3044	-43.92%	0.9439	0.9141
加权平均净资产收益率	1.21%	2.76%	2.47%	-1.26%	7.39%	7.14%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,516,135.01	303,982,000.80	327,761,588.18	318,426,340.35
归属于上市公司股东的净利润	-13,603,550.88	23,515,021.39	4,036,149.28	39,286,563.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,398,785.17	29,074,076.26	41,165,383.06	17,973,023.35
经营活动产生的现金流量净额	-74,296,371.44	-55,337,023.68	38,776,251.80	52,247,529.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052					
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	11.93%	37,397,976.00						
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	7.27%	22,788,086.00		质押		2,000,000.00		
SINYANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	4.32%	13,532,590.00						
孙慧明	境内自然人	1.78%	5,568,883.00						
金叶飞	境内自然人	1.58%	4,948,751.00						
金叶玲	境内自然人	0.84%	2,622,559.00						
陈晓钧	境内自然人	0.74%	2,333,700.00						
张滕	境内自然人	0.67%	2,108,884.00						
江苏新	境内非	0.66%	2,082,200.00						

潮科技集团深圳企业管理咨询有限公司	国有法人					
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。					

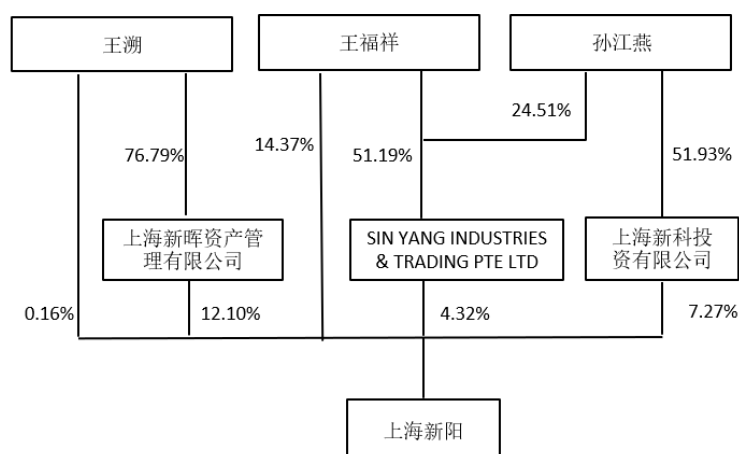
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

报告期内，公司面对外部环境不稳定、经济放缓、原材料大幅上涨、物流交通受阻等不利因素，积极落实研发、采购、生产、销售、运输各环节的应对措施，减少因外部因素、原材料价格上涨给公司带来的不利影响。2022 年全年实现营业收入 11.96 亿元，较去年同期增长 17.64%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1.12 亿元，同比增长 31.74%。得益于半导体产业的快速发展及公司新产品、客户的拓展，公司半导体行业实现营业收入 6.40 亿元，同比增长 27.34%，集成电路制造用超纯系列产品收入快速增加，同比增长超 90%。其中，集成电路制造用干法蚀刻后清洗液产品市场份

额持续扩大，氮化硅蚀刻液产品在客户端进展顺利，增长迅速。涂料业务板块克服报告期内建材行业不利影响，2022 年实现营业收入 5.56 亿元，较上年同期增长 8.16%。

### 1、半导体产能布局持续完善，产品规模加速放量

随着国家集成电路行业的蓬勃发展及半导体材料国产替代进程的加速，公司集成电路制造用关键工艺材料产品市场需求旺盛，公司于 2019 年启动集成电路关键工艺材料扩产项目，布局规划了清洗液、刻蚀液、电镀液及添加剂、光刻胶、研磨液等化学品材料产能，历经 2 年多的建设、调试、试生产等环节，目前上海厂区年产能 1.9 万吨扩充目标已建设完成。报告期内，公司化学品产出 1.18 万吨，较去年同比增加 16.84%，其中超纯化学材料产品产量增长超 50%以上。公司合肥第二生产基地项目适时调整，一期二期同时开展建设，合计规划产能 7 万吨，目前一期已在设备安装调试阶段。根据市场需求及公司在集成电路制造用关键工艺材料产能布局，现也启动位于上海化学工业区的项目建设，该项目主要用于开发光刻胶及配套材料产业化建设。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续完善，公司产品规模的不断放量，能够满足未来客户产能增长的需求。

### 2、发挥自主研发优势，增强公司核心竞争力

报告期内，面对产业发展及下游客户的需求，公司围绕核心业务技术，持续研发投入，创新产品，为客户提供整体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 1.24 亿元，占本期营业收入的比重为 10.36%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、氮化硅和氮化钛蚀刻液、干法蚀刻后清洗液、化学机械研磨液等项目。

在集成电路制造用清洗液产品方面，28nm 干法蚀刻后清洗液产品已规模化量产，14nm 技术节点后干法蚀刻后清洗液也已量产并实现销售，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。本报告期干法蚀刻后清洗液产品销售已超过亿元，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造领域。其中，铝互连干法蚀刻后清洗液长期受制于国外唯一原材料供应商限制，面对先进制程所需的配套材料亦需国产化的现状，公司经过自主研发攻关，“卡脖子”的关键原材料项目——非羟胺项目报告期内取得重大技术突破，已开发出满足晶圆制造企业要求的无羟胺干法蚀刻后清洗液产品。目



前该产品已通过国内主流晶圆制造客户的验证，标志着我司对铝制程清洗技术的理解与研发能力已走在世界前列。

在蚀刻液产品方面，公司紧跟芯片制造技术的发展和行业领先客户的先进制程，持续推进相关产品的研发，进行产品技术能力的储备，新一代更高阶产品的小试技术储备已完成，技术性能达到国际先进水平，未来相关系列产品持续在更多客户端上线验证，进一步扩大应用。目前已量产的应用于 128 层、192 层及以上的氮化硅蚀刻液产品已规模化销售，报告期内实现销售收入超 1 亿元。

在集成电路制造及先进封装领域，电镀系列产品——大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、凸点工艺（bumping）广泛应用，来实现金属之间的互联。电镀液及其添加剂是实现互联技术的关键工艺材料。经过多年的开发、技术储备，以及与客户紧密的合作，报告期内公司铜电镀液添加剂相关产品进展顺利，已量产销售并且应用持续扩大。

在光刻胶及研磨液两大类产品方面，报告期内均取得了不同程度的进展和突破。其中，光刻胶研发进展比较顺利，I 线、KrF 光刻胶已经在超 10 家客户端提供样品进行测试验证，并取得了部分样品的订单，通过测试验证，公司光刻胶产品工艺性能指标不断优化，以满足客户的工艺需求。此外，部分产品已获得晶圆制造企业小批量连续订单。后续 KrF 光刻胶的样品测试验证的范围和样品类别还将继续扩大，从而加速产业化目标的实现。ArF 浸没式光刻胶的研发进展也比较顺利，ASML-1900 光刻机安装调试进度符合预期，安装调试基本结束，公司研发的实验室样品目前取得的数据指标和对标产品大部分接近。公司与上海化学工业区达成建设生产基地的意向，目前正推进项目建设的各项前期工作。在布局的研磨液系列产品方面，公司的化学机械研磨液（CMP）技术也已有成熟的 STI Slurry、Poly slurry，W slurry 系列产品通过客户测试，进入批量化生产阶段。报告期内光刻及研磨两大系列产品实现营业收入超百万元。

公司多年来始终如一，坚持自主创新，充分挖掘自身潜力，与产业链上下游协同创新发展，坚定不移地围绕国家被“卡脖子”关键工艺材料产品，围绕公司核心技术持续突破，不断提升公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力。

### 3、强化基础管理，培养人才梯队

报告期内，随着企业发展逐步进入科技化、数字化、智能化及平台化的时代，公司在运营、研发和生产上紧跟时代及产业发展步伐，推进四化大趋势，执行基础数据上线，数据互通、业财融合的初步系统改造升级任务，充分利用信息技术产业软硬件的优势，为企业未来的智能化发展提供动力。

报告期内，虽然受到国内经济放缓、贸易战的一定影响，但公司业务规模仍旧保持良好增长，员工规模也随之不断扩大。截止本报告期末，公司员工总数达到 771 人，人员净增 119 人，其中半导体业务板块人员净增 98 人，增长率 24%。除了员工队伍规模的增长，公司在提升人员素质、加强团队整体能力方面不断突破：公司结合行业现状及公司发展规划，完善人才梯队建设，邀请行业专家开展讲座，并定期组织开展专业能力与非专业能力培训，内容涵盖技术、管理、办公等多方面，强化师徒带教的人才培养模式，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，让员工与公司共同成长，持续进步。

报告期内，公司持续推进薪酬证券化改革，通过股权激励及员工持股的一揽子计划来践行该机制，希望吸引、留住相关人才，让骨干员工共享企业发展成果。公司完成了 2021 年度股份回购计划，共使用近 8,000 万元人民币以集中竞价方式在二级市场回购公司股份 2,049,859 股。同时，开展 2022 年度股份回购计划，已回购公司股份 2,632,685 股。未来公司还会持续推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引、聚集优秀人才，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力的人才保障。

### 4、积极参与半导体产业链投资，助力半导体材料装备国产化

报告期内，公司一方面加深在研磨液材料行业的布局，受让上海晖研 100%的股权，增资苏州博来纳润，加快整合产业资源优势，推进部分产品及核心原材料自主可控供应的能力，积极向上游寻求合作。另一方面，公司亦积极参与产业投资，报告期内投资了苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮万芯创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴新区弘微创业投资基金中心（有限合伙）、上海成泉科技中心（有限合伙）等项目。在完善公司半导体产业链布局的同时，助力半导体材料装备发展，与公司主营业务产生协同作用，不断拓展和加强公司产业实力及行业影响力。

5、推动涂料业务板块独立挂牌，集中资源发展半导体业务

报告期内，公司启动了子公司江苏考普乐股份制改制并拟申请在新三板挂牌的项目，公司子公司已在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下逐步开展股份制改制、申请在新三板挂牌的相关工作，目前江苏考普乐公司已完成股份制改革，股本已增资扩大到人民币 6231.8 万元。公司积极推动控股子公司江苏考普乐独立挂牌、进入创新层项目，有利于进一步完善其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核心竞争力。同时公司本部能够集中资源发展半导体业务，有利于上市公司总体经营战略的实施，实现上市公司整体效益最大化。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2023 年 4 月 25 日